

# 2024中国电子信息博览会(第十二届深圳电子展)

产品名称	2024中国电子信息博览会(第十二届深圳电子展)
公司名称	FCE展览
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	15989233176

## 产品详情

2024第十二届中国电子信息博览会

The 12th China Information Technology Expo 2024

时间：2024年4月9-11日

地点：深圳国际会展中心(宝安馆)

参展联络：徐妍（手机号看联系栏）

创新驱动发展 智慧赋能未来

指导单位

工业和信息化部

深圳市人民政府

主办单位

赛艾特会展(深圳)有限公司

中国电子器材有限公司

中电会展与信息传播有限公司

深圳市博远国际展览有限公司

组织单位

## 展会概述

伴随我国新一代信息技术产业的快速发展，中国电子信息博览会(中文简称：电博会，英文简称：CITE)2024第十二届中国电子信息博览会定于2024年4月9-11日在深圳国际会展中心(宝安馆)举办，自2013年举办以来已走过了十一年征程。作为亚洲规模大的综合性电子信息博览会，电博会组委会以“全球视野，国际一流，创新引领，服务产业”为理念，为产业链上下游协同创新提供了高效交流平台，促进电子信息产业与国民经济各领域进一步融合赋能，推动中国数字经济实现高质量发展。

### 聚合创新资源，推进科技创新，促创新成果转化，增科技辐射力

近年来，随着集成电路、云计算、大数据、人工智能、5G、新型显示等数字技术的发展，人类社会正逐步进入数字经济时代，超高清视频、虚拟现实、先进计算等领域发展步伐进一步加快，信息技术与实体经济的融合日益深入，持续赋能经济社会智能化转型。

其中，电子信息产业作为数字经济的基础，已经成为推动经济社会高质量发展的重要支撑与关键引擎。2021年，规模以上电子信息制造业营业收入突破14万亿元，同比增长14.7%，占工业营业收入比重达11.0%，已连续九年保持工业大行业地位。今年上半年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.2%，高于规上工业增加值增速6.8个百分点，为保持经济运行在合理区间提供了有力支撑。

珠三角地区作为我国大的电子信息产品生产制造基地、全球重要的电子信息产业集聚区，并朝着电子信息产业集群发展不断迈进。2021年，广东规模以上电子信息制造业营业收入4.56万亿元，占全国32.3%，已连续31年位居全国第1；广东电子信息制造业企业有10家营收超1000亿元，19家企业进入2021年中国制造业500强，24家企业进入2021年全国电子信息百强，33家企业进入2021年全国电子元器件百强，数量均居全国第1。

2022年，广东省坚定推动高质量发展，加快建设现代产业体系，促进产业迈向全球价值链中高端，稳中求进培育发展以新一代电子信息产业集群为代表的20个战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群，大力发展半导体及集成电路、消费电子、超高清视频、硅能源等产业，出台一系列政策措施大力支持关键核心技术攻关，进一步优化和稳定产业链供应链，加快推动数字产业化和产业数字化，引进重大项目，布局重大平台，打造特色产业园区，营造良好的产业发展环境，促进电子信息产业成为推动实体经济提质增效、促进工业经济平稳增长、助力粤港澳大湾区建设的重要支撑力量。

### 持续推动创新链和产业链深度融合

中国电子信息博览会始终立足电子信息产业热土——深圳，放眼全国，辐射全球，设置了CITE主题馆、新型显示及应用馆、智电生活馆、电子数字生活馆、大数据云计算馆、新一代信息通信产业集群馆、创新智能科技互联应用馆、基础电子馆；聚焦智慧家庭、智慧终端、集成电路、5G应用、消费电子、新型显示、智能机器人、智能制造、电子元器件、信创、“专、精、特、新”等热点领域，随着数字经济、低碳绿色、国产替代成为经济发展的主流趋势，电博会不断推动内容创新与升级，助力数字生活、大数据、半导体、新能源、车联网、虚拟现实、元宇宙等领域不断加速融合创新，助力中国电子信息产业实现高质量发展。

### 同期高端热点活动金鑫，1+1+7+N洞见产业未来

为了提升中国电子信息博览会的性，CITE 2024创新优化推出“1+1+7+N”活动方阵；即举办“1”场中国电子信息博览会开幕峰会，举办“1”场新一代信息技术产业创新产品评选活动；“7”大重点领域方向活动“产业数字化”、“集成电路及半导体”、“超高清显示”、“智慧出行”、“信息技术应用创新”、“5G+应用”、“消费电子及数字生活”；同期还有“N”场平行论坛活动；来自电子信息领域的专家学者、企业高层齐聚一堂，共同探讨了电子信息产业的发展新趋势与新机遇。

## 中国电子信息行业创新奖及金奖

为评选表彰代表我国电子信息行业具有突破性、先进性、方向性的产品和应用，中国电子信息行业创新评选组委会将联合电子信息领域10大行业协会，共同组织评选“中国电子信息行业创新金奖”及“中国电子信息行业创新奖”，旨在打造代表我国电子信息行业高创新水平的奖项。

### 围绕新兴领域及技术，N场平行板块方向设坛活动

围绕电子信息产业重点领域与技术，把握“产业数字化”、“集成电路及半导体”、“超高清显示”、“智慧出行”、“信息技术应用创新”、“5G+应用”、“消费电子及数字生活”七大板块垂直领域论坛矩阵，及精心策划打造五十余场论坛活动，聚焦汽车电子、物联网、电力电子、医疗、教育、民生消费等热门应用市场与高速发展行业。

#### 展品范围

CITE品牌创新：智慧家庭、智能终端、信息安全、集成电路、大数据与存储、创新科技互联等。

新型显示及应用：元宇宙及虚拟现实技术、超高清视频、Micro-LED/Mini-LED、3D盖板玻璃、半导体显示、显示上下游材料及显示终端应用、电子纸供应链、智能穿戴和蓝牙音频供应链、TWS耳机新品、蓝牙耳机新品、智能声学新品等。

半导体产业及应用：半导体设备、半导体材料、半导体制造、半导体封装及测试、传感器及相关应用

电子生活生态：消费端电子、电子生活体验区、娱乐影像、跨境生态链等。

新一代信息产业制造：服务型机器人、工业机器人、3C产业制造、智慧工厂及自动化等。

物联智通应用技术：物联网应用、智慧城市、智慧交通等。

基础电子：电子元器件、仪器仪表及材料、特种电子、电子生产制造设备、IP及IC设计及解决方案等。

智能充电：电源芯片、第三代半导体、被动器件、新能源产品、消费类电源、智能化设备等。

智电生活：智电生活购物节、电竞环游GTS等。

大数据云计算：大数据与存储、Web3.0、数字藏品、元宇宙基础设施等。

智能驾驶与汽车电子技术、国际氢能产业链：智能新能源汽车、自动驾驶技术、智能辅助驾驶、车联网技术、国际氢能产业链等。

欢迎业界同仁踊跃报名参展CITE

2024，现正接受申请，请速与我们联系，索取参展合同及展位平面图！

知识科普：

什么是半导体封装？

半导体封装是指将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程。封装过程为：来

自晶圆前道工艺的晶圆通过划片工艺后被切割为小的晶片（Die），然后将切割好的晶片用胶水贴装到相应的基板（引线框架）架的小岛上，再利用超细的金属（金锡铜铝）导线或者导电性树脂将晶片的接合焊盘（Bond Pad）连接到基板的相应引脚（Lead），并构成所要求的电路；然后再对独立的晶片用塑料外壳加以封装保护，塑封之后还要进行一系列操作，封装完成后进行成品测试，通常经过入检Incoming、测试Test和包装Packing等工序，后入库出货。